

# 昆山正版Moldex3D哪家专业

发布日期：2025-10-08 | 阅读量：6

Moldex3D芯片封装解决方案IC封装是以环氧树脂材料(EpoxyMoldingpound,EMC)进行封装的制程，藉以达到保护精密电子芯片避免物理损坏或腐蚀。在封装的过程中包含了微芯片和其他电子组件(所谓的打线)、热固性材料的固化反应、封装制程条件控制之间的交互作用。由于微芯片封装包含许多复杂组件，例如：环氧树脂(EMC)硅芯片、导线架及高密度金线，故芯片封装制程中将会产生许多制程挑战与不确定性。常见的IC封装问题如：充填不完全、空孔、金线偏移、导线架偏移及翘曲变形等Moldex3D芯片封装模块提供完整系列的解决方案，包含：转注成型、毛细底部填胶(CUF)压缩成型、嵌入式晶圆级封装(EWLP)非流动性底部填胶(NUF)/非导电胶制程(NCP)针对网格生成，使用者可以选用自动化网格简单的项目设定；另外，针对更复杂封装组合，还可以采用手动产生网格的方式(例如：导线架与硅芯片堆栈)完成项目设定Moldex3D进阶热流道分析！昆山正版Moldex3D哪家专业

Moldex3D 产品概览 Moldex3D是塑料射出成型产业中的计算机辅助工程领导产品Moldex3D拥有前列的分析技术，可协助客户模拟更\*\*\*的射出成型应用范围，来优化产品设计和可制造性，以达到缩短上市时间并提高更大的产品投资回报率。特色 CAD嵌入式前处理 \*\*\*自动3D网格引擎 高解析三维网格技术 \*\*\*能平行运算 Moldex3D 网格 Moldex3D 网格支持各种不同的网格类型，包括 2D 三角形及四边形网格3D四面体、棱柱体、六面体voxel (brick)和金字塔型网格Moldex3D 网格提供多种主流网格方法：纯三角形表面、以四面体为主的表面网格；纯四面体网格、边界层网格、纯voxel网格、混合式实体网格及中间面简化网格。客户可从中选择符合自己的特殊模拟需求来建立网格模型。设计验证 (eDesign) 模流创新 (BLM) 模流创新 + (Solid) 自动化网格生成 自动化网格生成 手动化控制网格 (Hexa, Prism, Pyramid, Hybrid) CAD/PLM整合 CAD/PLM整合 制程优化 制程优化 特殊制程的支持 简单、快速、效率 精细、准确、效率 客制化、精细、准确 优势 具有强大的网格划分技术的前处理工具与支持不同的网格元素型态，以提高实体网格产生效率昆山模流分析软件Moldex3D多少钱Moldex3D软件试用\*\*下载。

- ▶ 比容比容数据可以在各种温度及压力下，经由\*\*的仪器测量得之(模型Gotech PVT-6000)比容数据对于计算塑料之体积收缩率相当必要。保压及翘曲分析需要使用比容数据，比容亦有利于流动与冷却分析。
- ▶ 热传导热传导可以在各种温度与压力下，利用Gottfert Rheograph 25特殊装置求得。热传导对于计算热塑性塑料之热移转相关情形相当重要，包括：冷却时间、温度分布...等。而热传导对于Moldex3D所有分析都不可或缺。
- ▶ 比热比热可经由标准热示差扫描卡量计 (Differential Scanning Calorimeter, DSC)(Model:

Perkin Elmer DSC-8500)测量得之。比热在所有热移转相关计算之重要性与热传导相同，而比热对于Moldex3D所有分析都相当重要。

- ▶ 化学流变学流变学专学研究在不同时间、温度和剪切率下的反应黏度。科盛利用平行板流变器(Model Anton Paar MCR502)发展出独有特性技术。流变学在计算主流道浇口压力、流动波前推进情况、锁模力…等相当重要。流变学在Moldex3D RIM分析上扮演不可或缺的角色。另外，经由特殊需求申请，仍可取得黏度过低之两液型热固性塑料的流变学资料。
- ▶ 固化反应动力学固化反应动力学为研究各种时间温度下的固化反应率。科盛已利用热示差扫描卡量计 (Differential Scanning Calorimeter, DSC)(Model: Perkin Elmer DSC-8500)发展出独有特性技术。固化反应动力学对于计算主流道浇口压力、流动波前推进情况、锁模力…等相当重要。而固化反应动力学对于Moldex3D RIM分析占有举足轻重之地位。共射出成型(COIM)!

一般案例分析我们结合了Moldex3D模流分析与实务经验，针对顾客产品研发需求提供独特解决方法。塑料产品设计必须与模型设计、塑料、及加工条件等元素紧密配合。我们提供的案例分析服务基于Moldex3D Flow/Pack/Cool/Warp的准确分析结果，提供产品设计及加工的优化方案和建议。

至今，我们已经分析超过8,000个业界实例；证明产品设计初期时，模流分析技术即可帮助认定生产及效能问题，并在生产前移除潜在问题。

经由Moldex3D分析与研发后的产品总体表现的更佳优良并能有效控制建模生产成本；客户轻松享受竞争优势之外，也能达成更高远的设计标的，并完成产品及时上市之任务！Moldex3D成功案例请联系苏州邦客思！昆山模流分析软件Moldex3D多少钱

### Moldex3D加热与冷却管理！昆山正版Moldex3D哪家专业

产业总览：塑料的应用范围已远远超出我们的日常生活，从个人护理、家居用品、食品及饮料包装、玩具、运动装备到电子零件和面板。换言之，塑料无所不在，在消费性产业中扮演着不可或缺的角色。然而，消费性产品业者必须面对千变万化的产业挑战，例如：大量生产、产品质量变化、节省原物料和开发时程，作出快速且正确的决策！Moldex3D优势！CAE塑料射出模拟技术已成为开发制程中不可忽视的趋势！Moldex3D提供真实稳定的三维解决方案，能缩短产品设计时程和节省制造成本。产品设计或开发者可以在产品设计初期即发现潜在缺点！Moldex3D模拟工具提供不同方案来降低产品变异以及优化生产制程！Moldex3D全程模拟将制程巨细靡遗一一剖析，引导用户全盘深入了解产品和设计验证过程。高精细模拟可大幅提升制程经济效益和产品竞争力，开创更臻至善的产品生命周期管理。问题挑战与Moldex3D解决方案挑战：不同材料有不同的热性质，因此热传递和材料兼容性是多材质射出成型产品（如：剪刀和牙刷把手）中的重要议题。如何在多种日新月异的材质应用下，控制翘曲量以维持产品尺寸稳定性，是多材质射出成型产品的一大挑战解决方案：采用Moldex3D Flow/Pack/Cool/Warp/MCM来分析收缩和翘曲的成因。 昆山

## 正版Moldex3D哪家专业

苏州邦客思信息科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的数码、电脑行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*邦客思供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！